



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100726000
2010 年 8 月 2 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

ASP TMS320DM335/DM355 製品 チップ一部改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施について通知のみを目的としたものになります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	☒ Design/Specification	☒ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	ASP TMS320DM335/DM355製品 チップ一部改定 現行： チップレビジョン1.1, 1.3 変更後：チップレビジョン1.4			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	8月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは9月上旬の出荷より予定しています。)			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。

弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) TMS320DM335/DM355製品について、製品機能向上の為に、チップレビジョンを現行 1.1, 1.3から1.4にチップ一部改訂し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
チップレビジョン	Revision 1.1, 1.3	Revision 1.4

理由：製品機能向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
DM355SZCE270	TMS320DM335ZCEA135	TMS320DM355CZCE216	TMS320DM355CZCEA21	TMS320DM355ZCE270
TMS320DM335ZCE135	TMS320DM335ZCEA216	TMS320DM355CZCE270	TMS320DM355ZCE135	TMS320DM355ZCEA135
TMS320DM335ZCE216	TMS320DM355CZCE135	TMS320DM355CZCEA13	TMS320DM355ZCE216	TMS320DM355ZCEA216

詳細：

今回のチップレビジョン変更に伴い、下記のように変更されます。尚、Revision 1.1, 1.3から1.4への変更は、ROMコードのみの変更になります。

相違点：

チップレビジョン1.1, 1.3, 1.4の違いは、ROMブートローダ(RBL)のバージョン、RBL動作の違いになります。それ以外の機能の変更はありません。

ROMブートローダ(RBL)：

ROMブートローダは、DM355/DM335製品の内部ROMに保存されたブートプロセスを管理するファームウェアです。ブートプロセスが呼び出されたとき、BTSEL[2:0]ピンのステートを調べ、そのステータに基づいて外部メディアからユーザブートローダ(UBL)をロードし、UBLのエントリポイントに分岐します。

レビジョン1.4の利点：

- ONFI準拠を含む非常に多くのRaw NANDデバイスをサポートしました。
- チップレビジョン1.1, 1.3と比較して多くのNANDデバイスをサポートしました。
- RBL 4bitエラーコレクションのバグを修正しました。
- 4th byte情報の検出、読み込み方法が新しくなりました。
- SPI EEPROMモードからのブートモードが追加されました。(NAND BTSEL[2:0]=000 Boot mode)

追加の詳細情報(Migration Guide)は下記を参照下さい。

DM335: <http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320dm335.html>

DM355: <http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320dm355.html>

下記のチップレビジョン1.4へ変更される発注型名に関するご質問は、担当営業にご確認下さい。

Revision 1.1	Revision 1.3	Revision 1.4
TMS320DM335ZCE135	N/A	TMS320DM335DZCE13
TMS320DM335ZCE216	N/A	TMS320DM335DZCE21
TMS320DM335ZCEA135	N/A	TMS320DM335DZCEA13
TMS320DM335ZCEA216	N/A	TMS320DM335DZCEA21
TMS320DM355ZCE135	TMS320DM355CZCE135	TMS320DM355DZCE135
TMS320DM355ZCE216	TMS320DM355CZCE216	TMS320DM355DZCE216
TMS320DM355ZCE270	TMS320DM355CZCE270	TMS320DM355DZCE270
TMS320DM355ZCEA135	TMS320DM355CZCEA13	TMS320DM355DZCEA13
TMS320DM355ZCEA216	TMS320DM355CZCEA21	TMS320DM355DZCEA21

製品表示

今回の変更に伴い、チップレビジョン 1.4 の製品名が“D”を含み、製品捺印が下記のようになります。

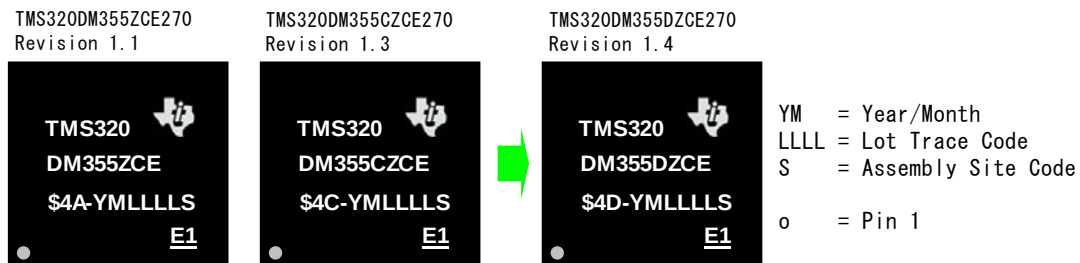


図1 捺印表示の例 (DM355 製品)

信頼性試験

チップレビジョン 1.1 の信頼性試験結果により、チップレビジョン 1.3 と同様にレビジョン 1.4 は認定されています。